

# 合肥晶合集成电路股份有限公司

## 2024 年年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

### 一、2024 年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	924,925.23	724,354.14	27.69
营业利润	48,316.17	11,557.58	318.05
利润总额	48,365.64	11,934.04	305.27
归属于母公司所有者的净利润	53,261.63	21,162.91	151.67
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	39,575.75	4,712.95	739.72
基本每股收益（元）	0.27	0.12	125.00
加权平均净资产收益率	2.51%	1.09%	增长 1.42 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	5,040,852.82	4,815,627.96	4.68
归属于母公司的所有者权益	2,086,620.12	2,140,980.47	-2.54
股本	200,613.52	200,613.52	-
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	10.74	10.58	1.51

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数；

2.以上财务数据及指标均以合并财务报表数据填列，未经审计，最终结果以公司 2024 年年度报告为准。数据如有尾差，为四舍五入所致。

## 二、经营业绩和财务状况情况说明

### （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内，公司实现营业总收入 924,925.23 万元，较上年同期增长 27.69%；实现归属于母公司所有者的净利润 53,261.63 万元，较上年同期增长 151.67%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 39,575.75 万元，较上年同期增长 739.72%。

报告期末，公司总资产 5,040,852.82 万元，较本报告期初增长 4.68%；归属于母公司的所有者权益 2,086,620.12 万元，较本报告期初下降 2.54%；归属于母公司所有者的每股净资产 10.74 元，较报告期初增长 1.51%。

受外部经济环境及行业周期波动影响，2023 年全球半导体市场的景气度相对低迷。2024 年，随着行业复苏，人工智能、消费电子拉动下游需求有所回暖，全球半导体市场触底后逐步回升。报告期内，公司积极聚焦主营业务，紧跟行业内外业态发展趋势，在巩固现有产品的情况下，持续扩大应用领域及开发高阶产品。同时，公司持续推进国内外市场的拓展，并不断提升经营管理效率和运营水平，产品的市场渗透率稳步提升。2024 年，公司订单充足，整体产能利用率维持高位，公司营业收入和净利润实现双增长，业务保持稳定发展态势。

### （二）上表中有关项目增减变动幅度达 30% 以上的主要原因

报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润和基本每股收益分别较上年同期增长 318.05%、305.27%、151.67%、739.72% 和 125.00%，主要系报告期内半导体行业景气度持续向好，公司积极把握市场机遇，加大市场开拓力度，收入规模持续增长。同时，公司整体产能利用率维持高位，单位销货成本下降，公司综合毛利率预计为 25.56%，较上年同期预计增加 3.95 个百分点。

## 三、风险提示

本公告所载的 2024 年度主要财务数据为初步核算数据,可能与公司 2024 年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据请以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日